

固体接触部のエネルギー散逸機構の解明とダンパへの応用

中村, 智也

<https://doi.org/10.15017/1931909>

出版情報 : Kyushu University, 2017, 博士 (工学), 課程博士
バージョン :
権利関係 :

氏名	中村 智也			
論文名	固体接触部のエネルギー散逸機構の解明とダンパへの応用			
論文調査委員	主査	九州大学	教授	杉村 丈一
	副査	九州大学	教授	西村 伸
	副査	九州大学	教授	雉本 信哉

論文審査の結果の要旨

本研究は、オイルレス機器用ダンパの減衰機構を明らかにするために実験と解析を行い、接触部において生じるエネルギー散逸の要因が主に摩擦と表面微小突起の塑性変形であることを明らかにし、エネルギー散逸量を解析的に求める手法を構築したものであり、ダンパの性能向上につながる、機械工学上価値ある業績として、博士（工学）に値するものと認める。